

Press Release

2023年6月26日

ドローン・ジャパン株式会社
イームズロボティクス株式会社



D.O.P.

(ドップ/ドローン・オープン・プラットフォーム プロジェクト)
～ドローン関連企業の技術連携プラットフォーム形成に向けて～

「ドローン オープンプラットフォーム プロジェクト」パートナー40社に拡大

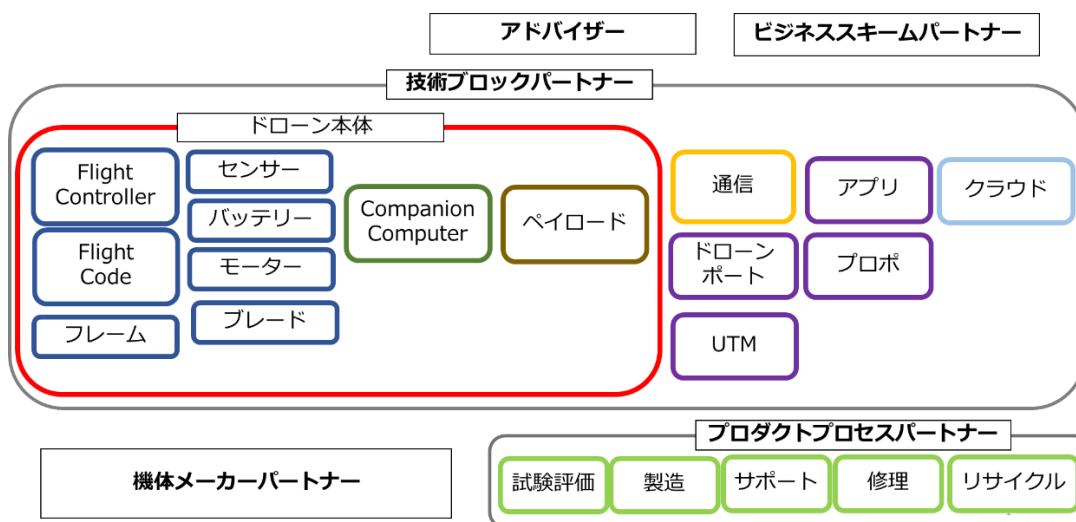
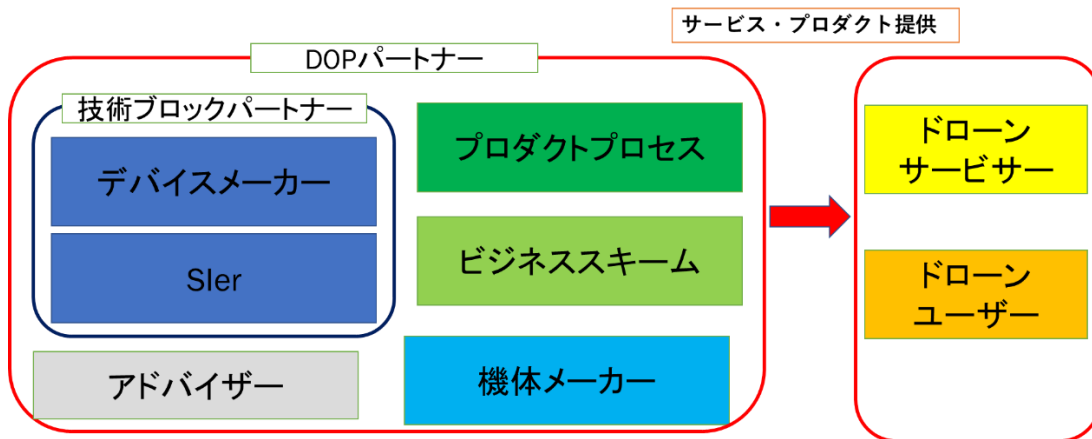
～ドローン関連企業の技術連携プラットフォームの形成に向けた
「ドローン オープンプラットフォーム プロジェクト」が拡大～

ドローン・ジャパン株式会社（所在地：東京都千代田区 代表取締役：勝俣喜一郎）は、国産ドローンメーカーとして機体開発のみならず、様々な分野で開発実績のあるイームズロボティクス株式会社（所在地：福島県南相馬市 代表取締役社長：曾谷英司）と協働し、その経験とパートナー連携を基に、国内ドローン関連の製品・サービスの社会実装を加速するため、各ドローン関連企業の技術連携が可能なプラットフォームを形成するための、「ドローン オープンプラットフォーム プロジェクト」（<https://www.drone-j.com/dopl/>）を推進してきました。

「ドローン関連企業の技術連携プラットフォーム形成に向けて」をコンセプトに推進してきた「ドローン オープンプラットフォーム プロジェクト」のパートナーは、昨年開始時の18社から40社に拡大しました（非公開4社含む）。

また、それまでの「技術ブロックパートナー」、「機体メーカーパートナー」、「アドバイザー」に加え、その技術連携をさらに加速するために、新たなパートナーカテゴリーとして「プロダクトプロセスパートナー」「ビジネススキームパートナー」を追加しました。

プロダクトプロセスパートナーは、機体評価、製造、サポート、修理、リサイクルなど製品サイクルに関わる分野を担うパートナー、ビジネススキームパートナーは、保険やリースなど運用性や安全性を高める分野を担うパートナーとなります。



1. ドローン オープンプラットフォーム プロジェクトとは

ドローン関連企業の技術連携プラットフォーム形成に向けて、ドローンを各技術ブロックやカテゴリーブロックに分解し、以下の実現を目的としています。

- 1) セーフティ・セキュリティリスクの軽減
- 2) 機体の運用管理の強化
- 3) ドローン用スマートデバイスの接続性向上

2. ドローン オープンプラットフォーム プロジェクトの成果物 (2023年6月現在)()内は会社名

技術ブロックカテゴリー別

フライトコントローラ

- ・ Flight BrainTM 「JFB-100」(フライトコントローラ) (日本航空電子工業)

バッテリー

- ・ インテリジェントリチウムイオン電池パック&専用充電器 (古河電池)

モーター

- ・ ドローン用高性能 ESC DR シリーズ (アスター)

ブレード

- ・プロペラ (チャレンヂ)

コンパニオンコンピューター

- ・DOP HUB 対応「プラットフォーム接続ユニット」(製品名未定) (ドローン・ジャパン)
- ・「BUD」(Brain Unit for autonomous Drone system) (アドバンテック)
- ・高可用性ドローン基盤ソフトウェア (仮称) (NEC ソリューションイノベータ)

ペイロード

- ・高解像度ジンバルカメラ CX-GB100/200/300/400 (ザクティ)
- ・パラシュート「Parasafe CA1201」(日本化薬)
- ・ドローン搭載用赤外線サーモグラフィ (日本アビオニクス)

プロポ

- ・テレメトリ無線機 画像伝送装置 (TKK ワークス)

アプリ

- ・Vitom Scanner MK3, Robin (Lidar センサー) (アプリ) (バイトム)

クラウド

- ・DOP SUITE シリーズ (機体管理・サポート基盤パッケージサービス) (サービス名未定) (ドローン・ジャパン)
- ・フライトログ暗号化サービス (クラウド) (パーソルクロステクノロジー)
- ・smart barrier (多要素認証サービス) (ラック)

機体メーカー

- ・E484MP/E6106FLMP/E6150MP (イームズロボティクス)
- ・QUKAI FUSION (空解)
- ・AIR HOPE AX-2601 (セブントゥーファイブ)
- ・スペースフレームドローン (テクノシステム)

3. プロジェクトパートナー (非公開4社あり)

<各技術ブロックサービス提供企業> (提供技術ブロック順・同一技術ブロック五十音順)

フライトコントローラ

- ・日本航空電子工業株式会社

フライトコード

- ・アルデュエックス・ジャパン株式会社

バッテリー

- ・古河電池株式会社

モーター

- ・株式会社アスター

ブレード

- ・株式会社チャレンヂ
- ・三井化学株式会社

コンパニオンコンピューター

- ・アドバンテック株式会社
- ・NEC ソリューションイノベータ株式会社
- ・パナソニック システムデザイン株式会社
- ・モーティブリサーチ株式会社

ペイロード

- ・株式会社ザクティ
- ・日本アビオニクス株式会社
- ・日本化薬株式会社
- ・日本工機株式会社

通信

- ・アルプスアルパイン株式会社

プロボ

- ・株式会社TKKワークス

アプリ

- ・バイトム株式会社

クラウド

- ・ドローン・ジャパン株式会社
- ・パーソルクロステクノロジー株式会社
- ・株式会社ラック

<機体メーカー> (五十音順)

- ・イームズロボティクス株式会社
- ・株式会社石川エナジーリサーチ
- ・五百部商事有限会社
- ・株式会社エアロジーラボ
- ・エアロセンス株式会社
- ・株式会社ACSL
- ・株式会社空解
- ・セプトーフファイブ株式会社
- ・テクノシステム株式会社
- ・東光鉄工株式会社
- ・株式会社プロドローン

<プロダクトプロセスパートナー> (五十音順)

- ・株式会社ジェットシステム
- ・VFR 株式会社

<ビジネススキームパートナー> (五十音順)

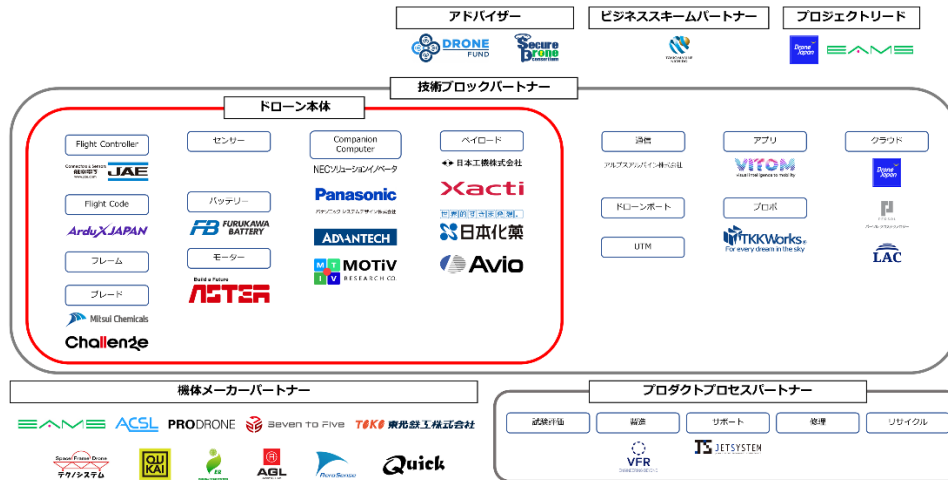
- ・東京海上日動保険株式会社

<アドバイスパートナー>

- ・一般社団法人セキュアドローン協議会
- ・DRONE FUND

DOPのパートナーマップ

ドローン オープンプラットフォームプロジェクトのパートナーマップ



パートナーマップ (2023年6月25日現在)

4. 今後の目標と取り組み

2023年度中：

プロジェクトメンバー数

- ・技術ブロックサービス提供企業：40社
- ・機体メーカー：20社

プロジェクトメンバーの技術を活用するドローンサービス企業数：10社

プロジェクトメンバーの技術を活用するユーザー企業数：40社

2025年度までに：

- ・プロジェクトの活用によるドローン市場 7,000億円への拡大(現状 5,861億円予想<インプレス総合研究所>)
- 各業務分野における技術適正化によるドローン活用市場拡大による。

海外への展開：

本プロジェクトが連携を予定する海外のプロジェクトは、既に世界で1,000社以上が参加するオープンソースコンソーシアムです。各国の機体メーカー、センサーおよびデバイスメーカー、ソフトウェアハウスがそれぞれのシステムを提供する中、日本プロジェクトはハードウェアやソフトウェアにおいて共通のルールやドキュメントを揃えることで、グローバル展開への後押しとしたい考えです。

本プロジェクトを通して参加メンバーが、健全に“競争”し、業界全体の拡大のため“共助”できるような取り組みとなるよう目指して参ります。

<問い合わせ先>

ドローン・ジャパン株式会社 会長 春原久徳

- ・メールアドレス：info@drone-j.com
- ・電話：03-6869-1384

イームズロボティクス株式会社 事業推進本部 曾谷・宇田

- ・メールアドレス：info@eams-robo.co.jp
- ・電話：049-293-4567